

エレクトロニクス実装学会九州支部 2025夏季講演会

日時： 2025年8月20日（水） 13:00～16:40
会場： 九州大学西新プラザ およびWEB配信
<https://nishijinplaza.kyushu-u.ac.jp>
定員： 現地50名（先着順）、WEB配信は制限なし
会費： エレクトロニクス実装学会会員：5,000円
非会員8,000円 学生：無料



（スケジュール）

13時00分～13時10分 支部長挨拶：池田 徹（鹿児島大学）

13時10分～14時20分 講演者：青柳昌宏 熊本大学卓越教授

講演タイトル：三次元積層実装技術の基盤研究開発について

講演概要：半導体ICの三次元化技術として、TSV、バンプを用いてICチップを積層化する技術について、DRAMなどのメモリICでは既に製品化されている。ロジックICについて、実装プロセス、設計、放熱、検査など、いろいろな課題があり、これまで当方が産総研および熊本大学で取り組んできた基盤技術開発について、ご紹介する。

14時20分～14時30分 休憩

14時30分～15時30分 講演者：有田 潔（西日本工業大学教授）

講演タイトル：プラズマダイシングプロセスにおけるパーティクルフリー工法の実現

講演概要：パーティクルフリーやダメージフリー等の特長を持つプラズマダイシングは、ハイブリッドボンディング等の半導体中工程への応用が期待されている。本発表ではプラズマダイシングプロセスの特長、装置および工法を解説すると共に、パーティクルフリーの実現に向けた工法開発について説明する。

15時30分～15時40分 休憩

15時40分～16時40分 講演者：佃 昌治（株式会社 東京精密）

講演タイトル：ウエハ薄片化バックグラインド技術について

講演概要：近年、パッケージ技術の発展に伴いバックグラインド技術は従来の基板薄化目的からデバイス、もしくはパッケージ自体の機能向上を目指す手段に至るまで適用範囲を拡大しています。本講演ではバックグラインド工程の基礎、弊社独自の高剛性技術、求められる最新技術動向を紹介致します。

17時30分～19時30分 懇親会 福岡市西新付近（＊場所、検討中、¥6000.-程度の会費を予定）

【お申込み】

下記 Webサイトからお申込み下さい。

参加申込みはここから

お申込み締切：2025年8月1日(金)

※定員に達し次第、締め切ります

＊訪問先のご意向により、同業者様のご参加はご遠慮いただいております。あらかじめご了承ください。

お問い合わせ：一般社団法人 エレクトロニクス実装学会 九州支部 事務局

E-mail: info@jiep.or.jp